

合肥芯碁微电子装备股份有限公司

投资者关系活动记录表

股票简称：芯碁微装

股票代码：688630

编号：2024-04

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input checked="" type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他（电话会议）
参与单位名称	UBS Securities、East Capital Asset Management、Khazanah Nasional Berhad、Lygh Capital、Matthews International Corporation、Newton Investment Management、Polunin Capital Partners Pte Ltd、Shanghai MegaTrust Investment Management、UG Investment Advisers。
时间	9月4日上午
地点	芯碁微装产业园内
公司接待人员姓名	董事会秘书、财务总监：魏永珍 首席科学家：曲鲁杰
投资者关系活动主要内容介绍	<p>一、董事会秘书兼财务总监魏永珍女士对公司2024半年度经营业绩、行业风向及需求、市场开拓和产品计划等相关情况介绍</p> <p>二、互动交流</p> <p>1、二期园区产能提升情况如何？</p> <p>答：公司二期园区产能约为一期的2-3倍，二期园区预计今年年底完成基建工程，接下来将尽快完成园区装修并投产，整体建设节奏紧凑，预计于明年年中释放产能。</p> <p>2、泰国子公司进展如何？</p> <p>答：今年上半年泰国子公司已完成注册，目前已有员工近20人，包括市场销售人员和运维工程师。后续将根</p>

据市场需求和业务进展等具体情况分阶段实施对泰国子公司的投资与建设。

3、公司 PCB 业务的营收占比情况？

答：今年公司 PCB 业务营收占比预计在 70%左右，PCB 在公司营收中仍占较大份额，下游客户今年对高阶板的需求增速较快，高阶头部客户的订单需求趋势较为确定，未来公司会不断提高 PCB 中高阶产品的市场占比。

4、卷对卷曝光设备销售情况如何？

答：公司卷对卷直接成像设备（RTR 系列产品），采用高精度的成像和定位系统，结合卷对卷上下料系统，为 FPC 制程提供了完美的解决方案。RTR 系列作为公司 PCB 设备中的明星单品，在设备精度、性能、产能等方面表现优异，并取得国际头部 PCB 厂商深度认可。近年来，随着折叠屏电子产品的渗透率快速增长，卷对卷直接成像设备出货量也有较快提升。

5、今年出口订单增速如何？

答：2023 年公司海外订单占比不高，今年公司加大了东南亚地区的市场布局，目前进展不错，海外订单较去年可能会有较大的增幅。目前全球 PCB 厂商纷纷赴东南亚建厂，同时叠加 PCB 技术升级，高端 HDI、SLP、载板、ABF 载板等成为厂商的主要扩产方向，直写光刻在精细化线路方向上成为最佳方案，行业资本开支有望带动公司业绩持续向上。

6、公司设备毛利率情况？

答：今年上半年，公司设备综合毛利率在 46%左右（新会计准则追溯前）。PCB 方面，公司一直注重降本提效；泛半导体方面，设备交付周期较长，设备解析精度、产能效率等要求较高，毛利率相对 PCB 产品较高。

7、先进封装设备预计什么时候会有量产需求？

答：随着 5G、物联网、高性能运算、智能驾驶、AR/VR 等场景的高端芯片需求持续增加，先进封装技术在整个封装市场的占比正在逐步提升，3D 封装、扇型封装（FOWLP/PLP）、微间距焊线技术，以及系统级封装（SiP）等技术的发展成为延续摩尔定律的重要途径。目前，在 IC 先进封装领域，掩膜光刻技术是产业中应用的主流技术，主要厂商以日本 ORC、美国 Rudolph 等日本、欧美地区企业为主，近年来，针对掩膜光刻在对准的灵活性、大尺寸封装以及自动编码等方面存在局限的情况，直写光刻技术的优势充分体现出来，公司直写光刻设备在先进封装中除了无掩膜带来的成本及操作便捷等优势，在再布线、互联、智能纠偏等方面都很有优势，同时，应用在更高算力的大面积芯片上的曝光环节会比传统曝光设备拥有更高的产能效率和成品率。未来，随着激光直写光刻技术在 IC 先进封装领域内的应用逐步成熟并占据一定的市场份额，公司封装设备需求将具有良好的市场前景。

8、PCB 和泛半导体验收周期如何？

答：公司 PCB 产品量产机型约 15-20 天就能安排发货，客户方验收约 1-3 个月不等；泛半导体交付周期相对较长，安装调试验收 3-6 个月以上。

9、公司 PCB 设备订单来自新产线建设需求和产线升级迭代需求的占比情况？

答：今年 PCB 订单的新产线建设需求主要来自东南亚海外订单，需求占比约在三成以上；国内设备订单约一半以上来自升级迭代需求。

10、公司订单从今年二季度到目前是比较饱满，这种旺季趋势预计能延续多久？

答：今年二季度以来，PCB 行业稼动率较第一季度

	<p>有所提升，公司生产端从四月份开始已达满产状态。下游客户对高阶板的需求增速较快，高阶头部客户的订单需求趋势较为确定，叠加下游客户在东南亚产能的转移，海外订单增长趋势明显。新增订单需求按照行业资本开支进度，目前预计增量趋势将持续 2-3 年。</p> <p>11、半导体设备毛利率未来趋势如何？</p> <p>答：毛利率未来可能会有微调，但不会跨度很大，公司会通过降低供应链价格、新品开发、技术提升和降本增效来维持毛利率水平。</p> <p>12、半导体业务能否拆分下游业务的占比？今年哪块业务的绝对增量更多？</p> <p>答：泛半导体领域主要有三块业务，分别是载板、先进封装和功率分离器件相关曝光设备。今年先进封装增速不错，载板持续维持增长，下半年增速可能更快一点。显示设备今年也有机会，已成功切入头部客户京东方供应链，目前屏幕传感器 RTR 设备已发货至京东方，LCD 制程曝光打码量产设备也即将出货。半导体领域同时不断推出新品，包括键合、对准、激光钻孔设备，对半导体业务未来增长都有着稳定的产品和市场支撑。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2024-9-4